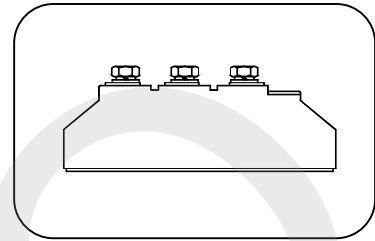


特点：

- n 芯片与底板电气绝缘,3600V 交流电压
 - n 全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
 - n 体积小,重量轻
- 典型应用：**
- n 交直流电机控制
 - n 各种整流电源
 - n 变频器

| | |
|-------------|------------------|
| $I_{F(AV)}$ | 110A |
| V_{RRM} | 1900~3000V |
| I_{FSM} | 2.6 KA |
| I^2t | 34.4 $10^3 A^2S$ |



| 符号 | 参数 | 测试条件 | 结温 $T_j(^{\circ}C)$ | 参数值 | | | 单位 |
|---------------|-------------|---|------------------------|------|----|-------|--------------------|
| | | | | 最小 | 典型 | 最大 | |
| $I_{F(AV)}$ | 正向平均电流 | 180° 正弦半波, 50Hz 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$ | 150 | | | 110 | A |
| $I_F(RMS)$ | 方均根电流 | | 150 | | | 173 | A |
| V_{RRM} | 反向重复峰值电压 | $V_{RRM} tp=10ms$ $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$ | 150 | 1900 | | 3000 | V |
| I_{RRM} | 反向重复峰值电流 | $V_{RM}=V_{RRM}$ | 150 | | | 12 | mA |
| I_{FSM} | 正向不重复浪涌电流 | 10ms 底宽, 正弦半波, | 150 | | | 2.60 | KA |
| I^2t | 浪涌电流平方时间积 | $V_R=0.6V_{RRM}$ | | | | 34.4 | $A^2s \times 10^3$ |
| V_{FO} | 门槛电压 | | 150 | | | 0.85 | V |
| r_F | 斜率电阻 | | | | | 1.88 | mΩ |
| V_{FM} | 正向峰值电压 | $I_{FM}=330A$ | 25 | | | 1.55 | V |
| $R_{th(j-c)}$ | 热阻抗(结至壳) | 180° 正弦半波, 单面散热 | | | | 0.330 | $^{\circ}C/W$ |
| $R_{th(c-h)}$ | 热阻抗(壳至散) | 180° 正弦半波, 单面散热 | | | | 0.15 | $^{\circ}C/W$ |
| V_{iso} | 绝缘电压 | 50Hz, R.M.S, $t=1min$, $I_{iso}=1mA(max)$ | | 3600 | | | V |
| F_m | 安装扭矩(M5) | | | | | 4 | N·m |
| | 安装扭矩(M6) | | | | | 6 | N·m |
| T_{stg} | 贮存温度 | | | -40 | | 125 | $^{\circ}C$ |
| W_t | 质量 | | | | | 160 | g |
| Outline | 217F3/223F3 | | | | | | |

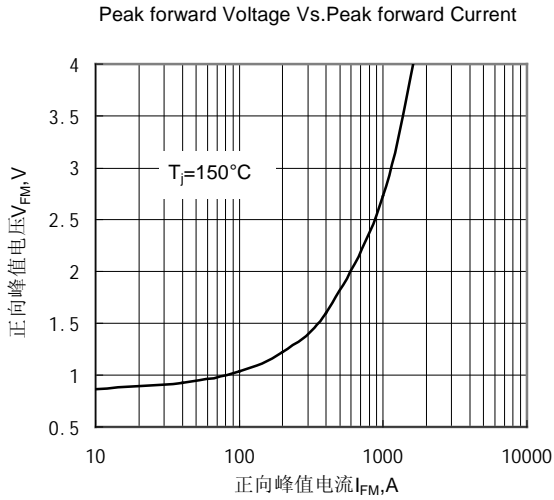


Fig.1 正向伏安特性曲线

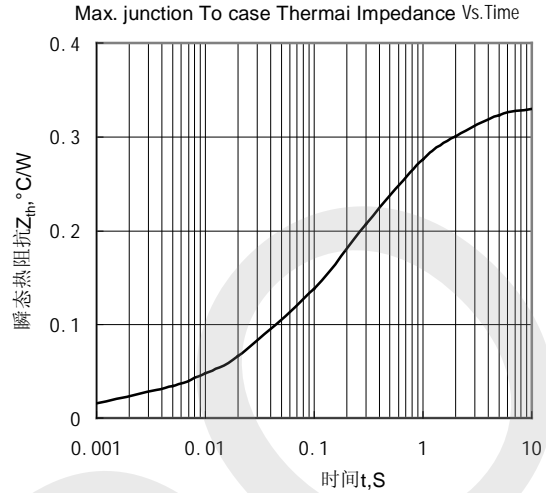


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

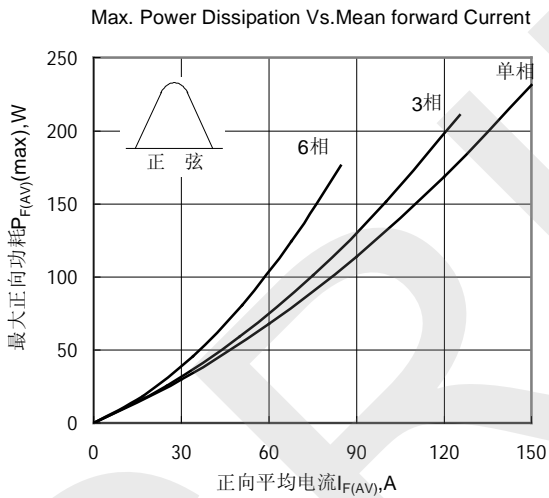


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

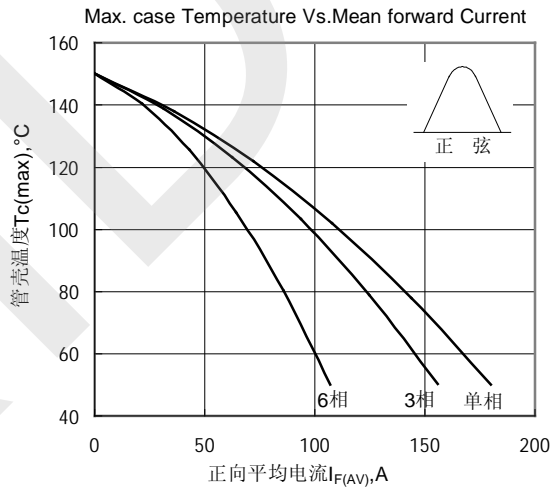


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

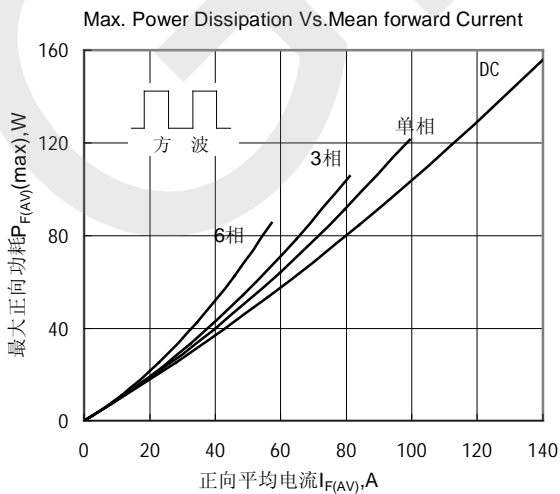


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

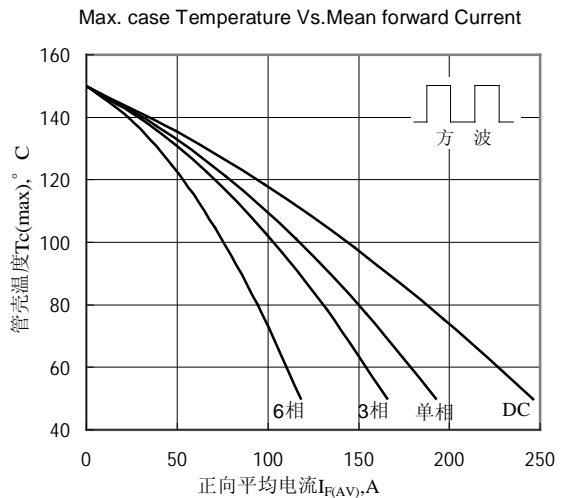


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

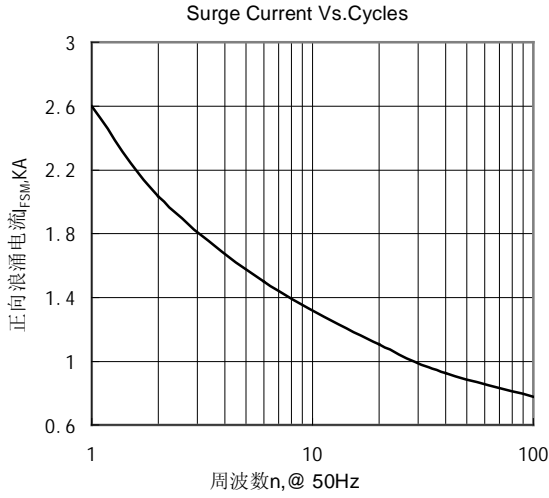


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

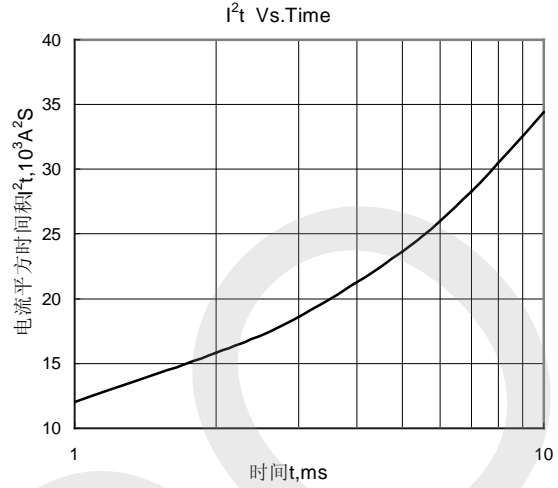
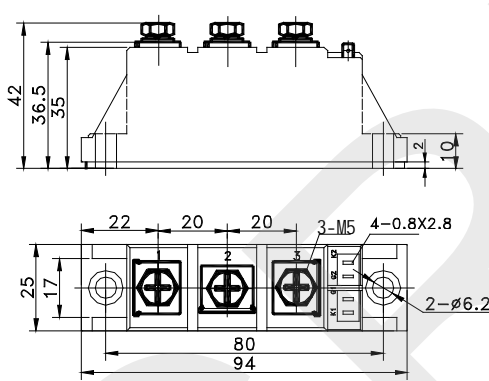
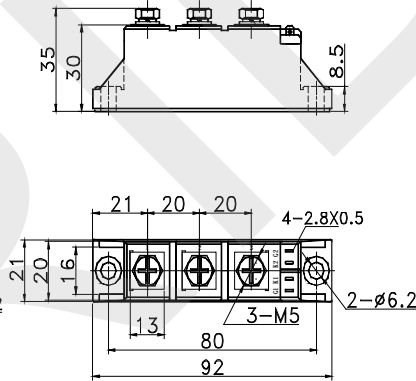


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形图:



217F3



223F3

